

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/202153 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 5/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C09J 11/08 (2006.01) C09J 7/30 (2018.01)
C09J 183/05 (2006.01) B32B 7/12 (2006.01)
C09J 183/07 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/008678

(22) 国際出願日: 2022年3月1日(01.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-052890 2021年3月26日(26.03.2021) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 福田 拓也 (FUKUDA Takuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

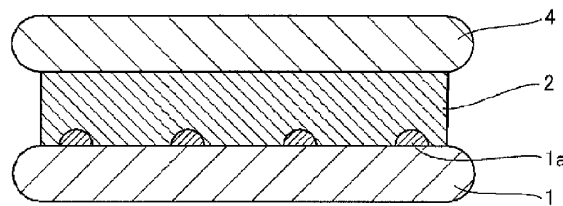
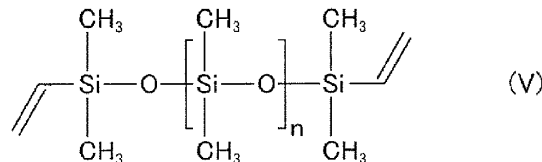
森谷 俊介(MORIYA Shunsuke); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
緒方 裕斗(OGATA Hiroto); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, LAYERED PRODUCT, METHOD FOR PRODUCING LAYERED PRODUCT, AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、積層体、積層体の製造方法、及び半導体基板の製造方法



(57) Abstract: Provided is an adhesive composition which is suitable for temporarily bonding a bumped semiconductor substrate to a supporting substrate and which gives an adhesion layer that can inhibit or reduce bump deformation caused by an external burden, e.g., heating, and that exhibits a high etching rate. The adhesive composition includes an adhesive ingredient (S), wherein the adhesive ingredient (S) includes a polyorganosiloxane ingredient (A) that cures upon hydrosilylation reaction, the polyorganosiloxane ingredient (A) including a polymer (V) represented by formula (V) having a weight-average molecular weight of 60,000 or higher. (n, indicating the number of repeating units, is a positive integer.)

[続葉有]



WO 2022/202153 A1

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: バンプ付き半導体基板と支持基板とを好適に仮接着可能であり、加熱等の外部からの負荷によるバンプ変形が抑制又は緩和でき、高いエッチングレートを示す接着層を与える接着剤組成物を提供する。接着剤成分(S)を含む接着剤組成物であって、前記接着剤成分(S)は、ヒドロシリル化反応により硬化するポリオルガノシロキサン成分(A)を含有し、前記ポリオルガノシロキサン成分(A)は、下記式(V)で表され、重量平均分子量が60,000以上である重合体(V)を含有する、接着剤組成物である。(nは、繰り返し単位の数を示し、正の整数である。)